

# SiCにおけるキャリア再結合 電気・機械工学専攻 准教授 加藤 正史

#### 概要

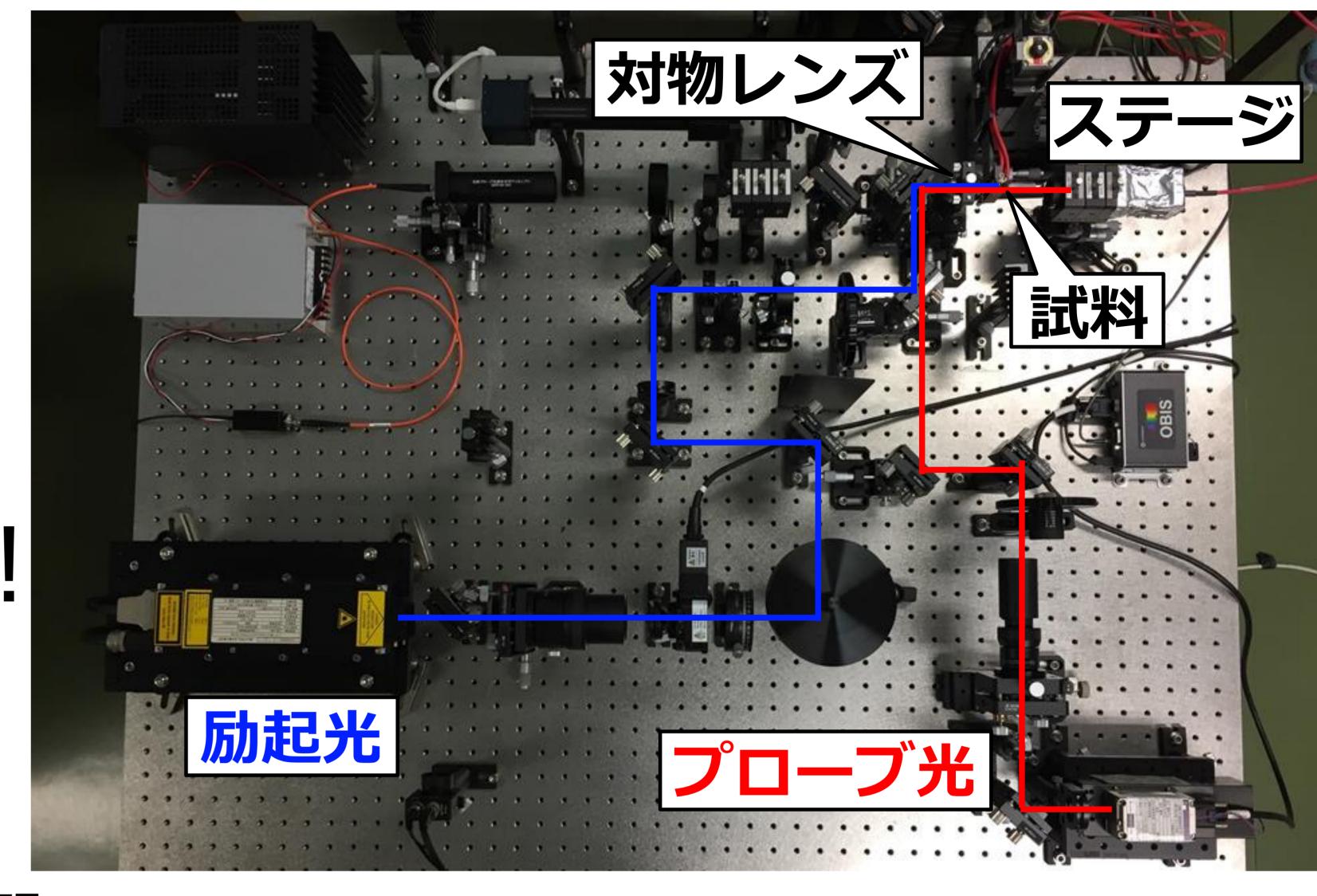
半導体SiCの特性を観る! キャリア寿命を通じて 微細な欠陥分布を測定 欠陥を制御し、高性能化

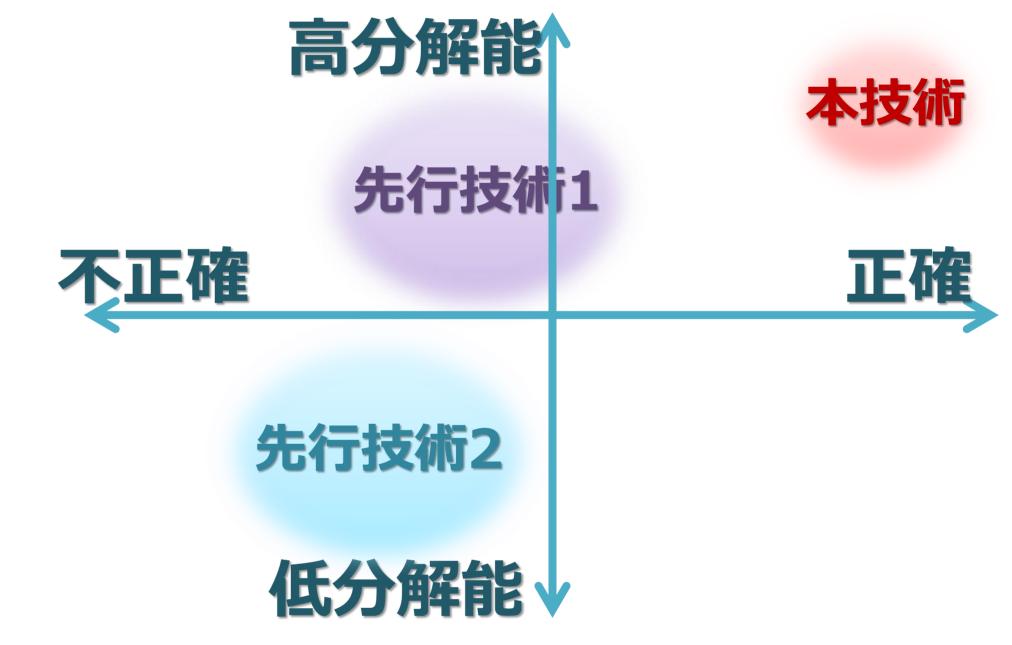
### 特長

- ●高NA対物レンズによりレーザを集光
- ●光の波長限界に近い3 μm程度の空間分解能を実現
- ●キャリア寿命の測定値も正確

	正確さ	分解能	測定時間
本技術		<b>3</b> μ <b>m</b>	△ >1 時間
先行技術1		<b>Χ</b> 100 μm	30 分
先行技術2		X <sub>1 mm</sub>	( )30 分

星取表による先行技術との比較





ポジショニングマップによる先行技術との比較

### 本技術が拓く心豊かな未来社会の姿

省工ネ電力機器を実現するSiC素子の実現・高性能化電気がより手軽に幅広く利用可能に! 省工ネ都市・社会の実現!

#### 今後の課題

- ・高空間分解能での材料品質評価へ 欠陥を制御することによる素子性能の向上が目標
- ・SN比の向上とそれに伴う測定時間短縮

## 求める連携先とメッセージ

- ●半導体素子・材料メーカーとの連携を希望
- 本測定装置での評価を希望する方はお気軽に!

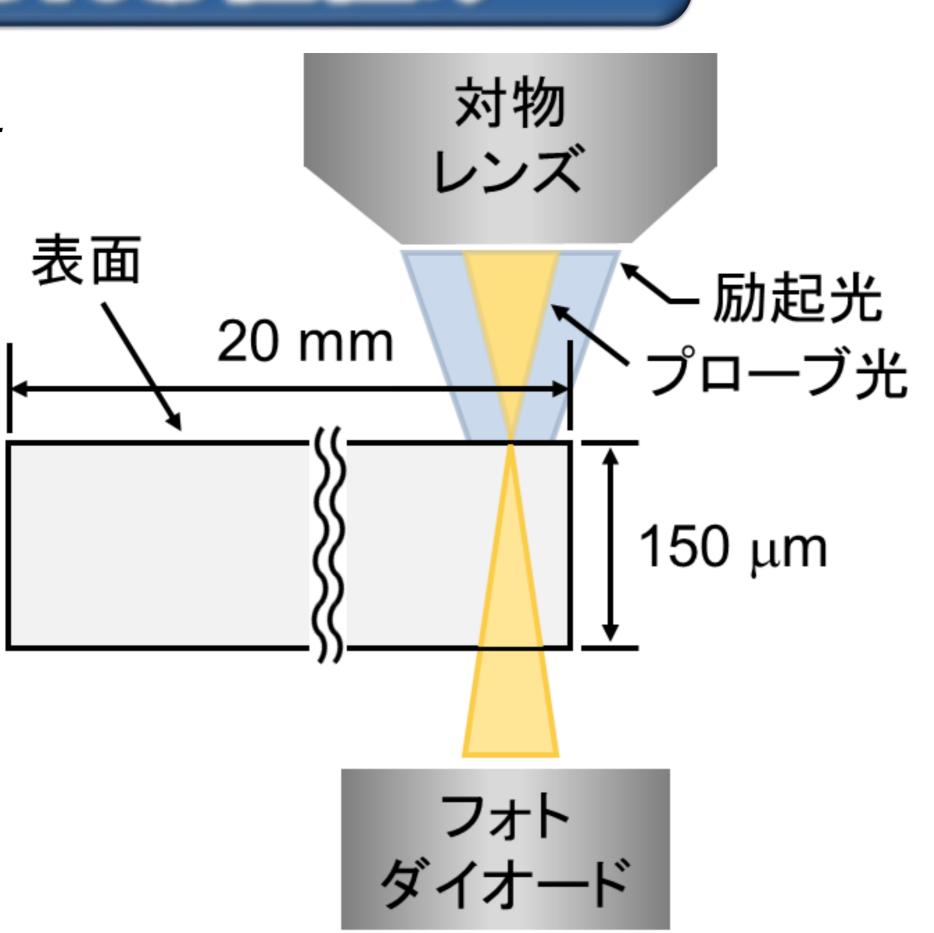


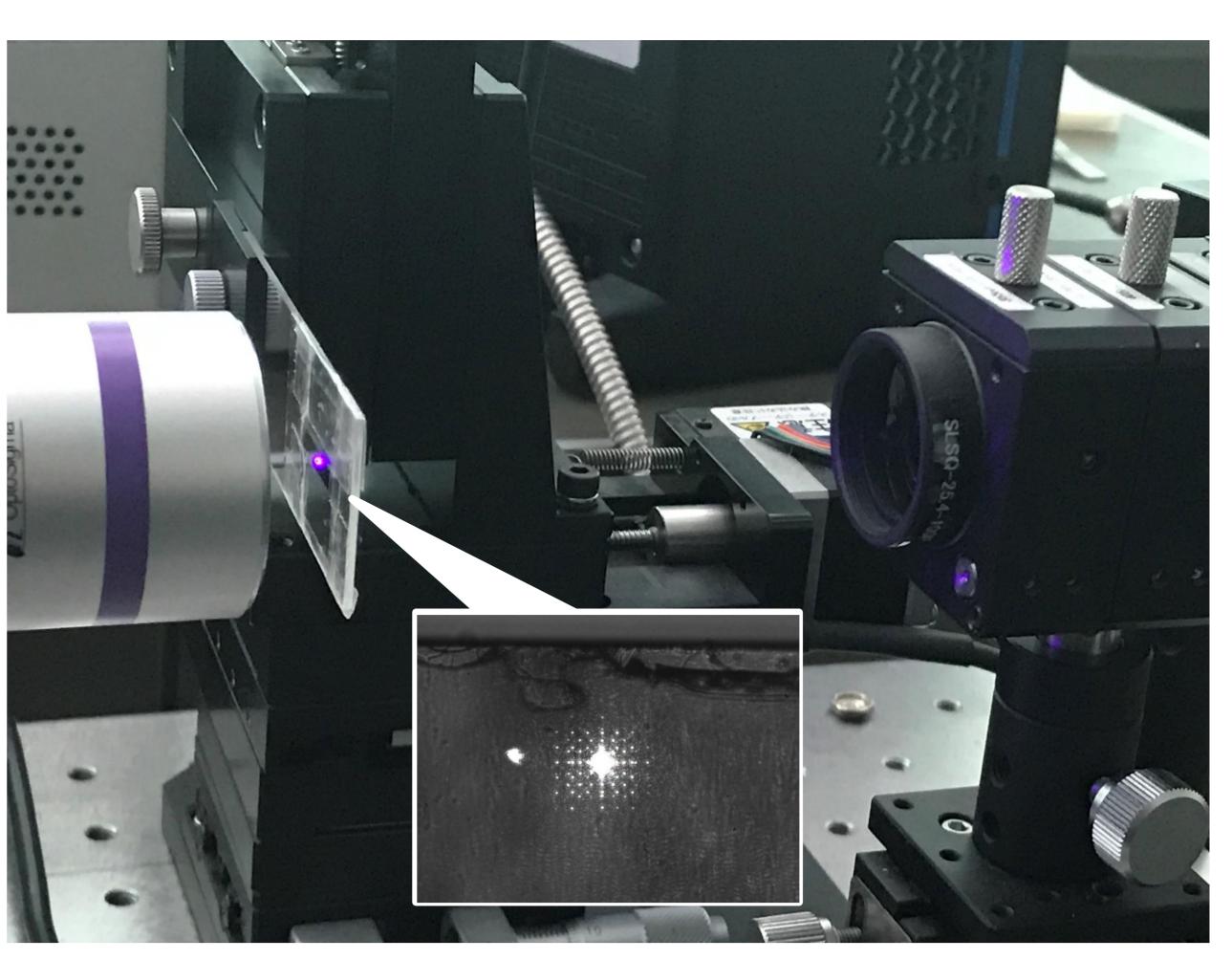
FIRST木本恒暢プロジェクト作成



### 特長が発揮される仕組み

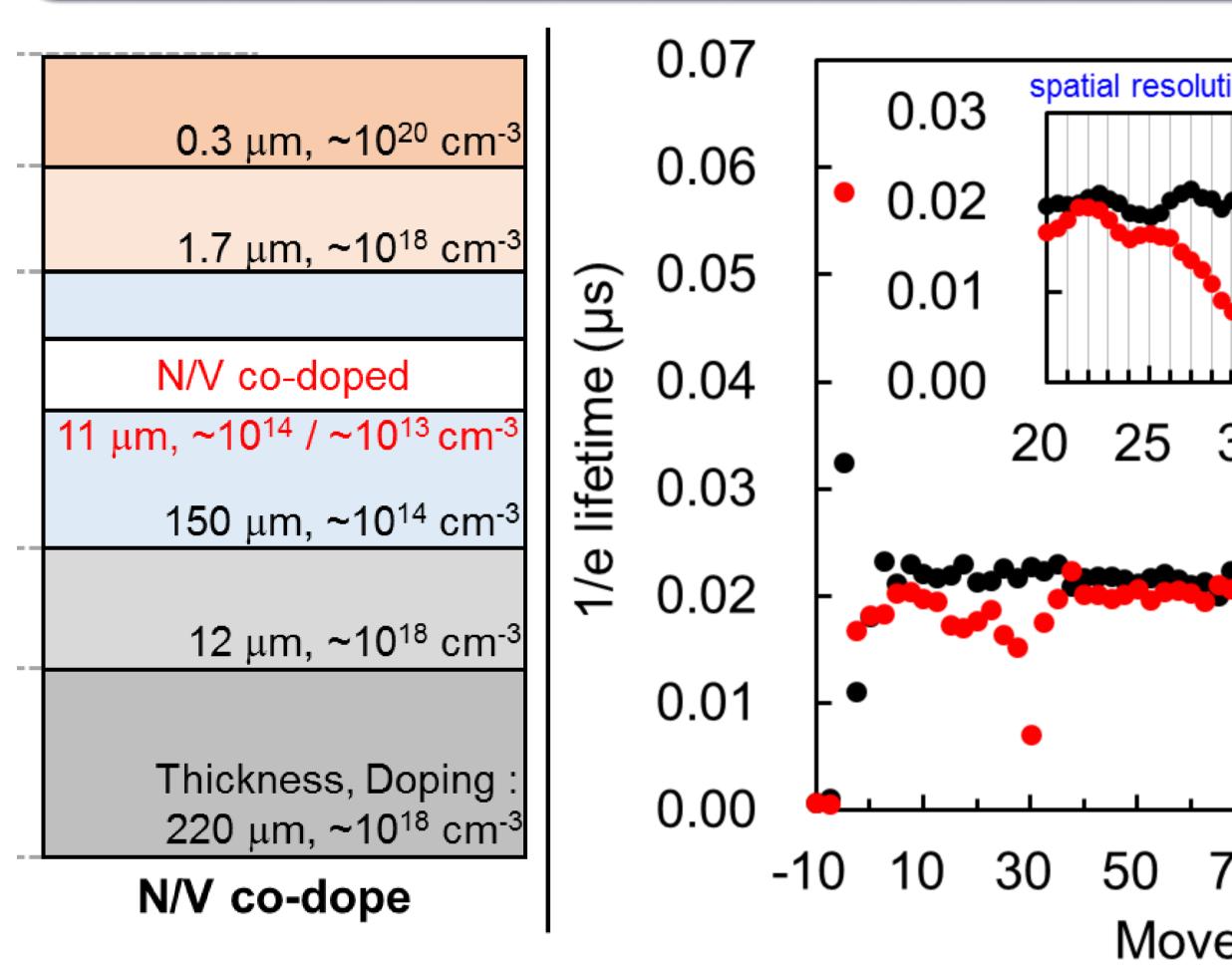
- 高NAの対物レンズを通 しパルス励起光を照射 し、キャリアを生成
- プローブ光を対物レン ズを通して集光し、透 過光強度の変化を観測
- プローブ光のスポット 径~1 μmにより高空間 分解能を実現





測定中の写真 (試料にレーザーを集光した時のCCDカメラ像)

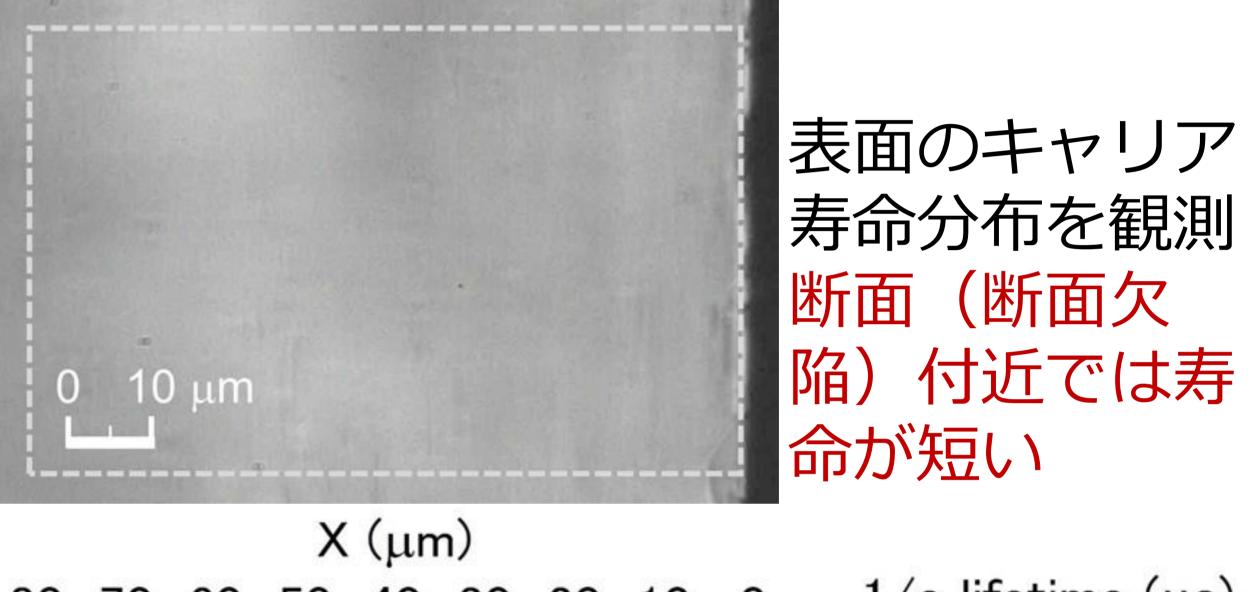
# 技術の特長の根拠となる実験データ等

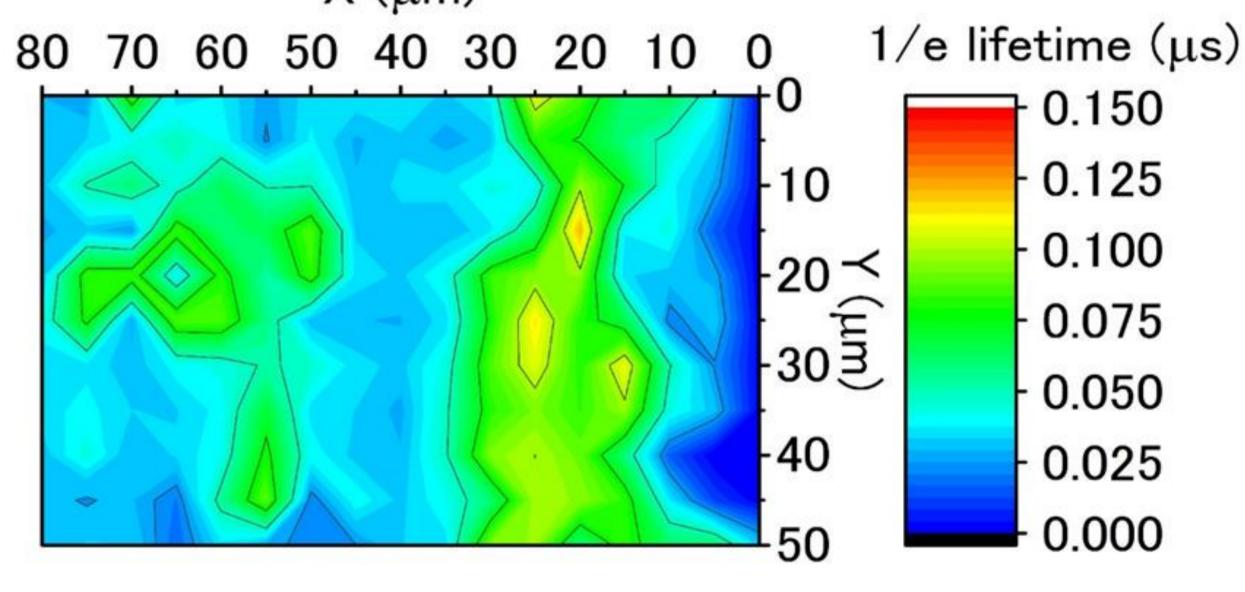


spatial resolution: ~3 μm N dope N/V co-dope 35 30 50 70 90 110 130 150 170 Movement (µm)

厚み11 μmの不純物層におけるキャリア寿命の低下を 断面測定により観測

不純物(欠陥)分布を正確に把握できる!





#### 試作品の状況

無し

#### 研究フェーズ

基礎固め

実用性評価

原理検証

開発研究

技術移転可

### 文献・特許の情報

- J. Linnros, J. Appl. Phys. 84, 275 (1998).
- S. Mae et al., Mater. Sci. Forum 924, 269 (2017).
- P. Scajev et al. J. Luminescence 212, 92 (2019).
- S i C結晶、電気特性を非破壊測定 名古屋工大(日刊工業新聞2019年1月10日)
- プレスリリース https://www.nitech.ac.jp/news/press/2018/7167.html

#### (お問合せ) 名古屋工業大学 産学官金連携機構

〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町字木市29番

TEL:052-735-5627 FAX:052-735-5542

E-mail: nitfair@adm.nitech.ac.jp URL: https://technofair.web.nitech.ac.jp/